

INVESTOR RELATIONS

2020 YMT IR BOOK

Your Most trustworthy



유의사항 [Disclaimer]

본 자료는 한국채택국제회계기준 연결실적에 대한 경영실적 및 재무성과를 바탕으로 작성되었습니다.

또한 본 자료는 미래에 대한 "예측정보"를 포함하고 있으며, 이러한 "예측정보"는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 불확실성으로 인하여, 실제 경영현황 및 재무실적에 긍정적 또는 부정적으로 영향을 미칠 수 있습니다.

- 국내외 국가정책변경에 따른 세율 변동 (FTA, 관세, 법인세 등)
- 환율 및 이자 변동을 포함한 국내외 금융시장의 동향
- 주요 매출시장의 환경의 예상치 못한 급격한 변화
- 회사내의 전략적인 의사결정

이러한 불확실성으로 인해 회사의 실제 미래실적은 "예측정보"에 기재되거나 암시된 내용과는 중대한 차이가 있을 수 있습니다.



Total Solution for Customer

와이엠티는 공정의 첫 단계인 세정,박리제 부터 최종 표면처리 까지의 모든 화학소재 기술을 보유하고 있습니다.이에 저희는 고객사 설비 특성에 맞는 Total chemical solution을 제공하고 있습니다.



최종표면처리

Final Finishing Chemical

Soft ENIG Process

- ✓ CF 300 Series
- ✓ MIKO Series

ENIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ MIKO Series

ENEPIG Process

- ✓ PEN Series
- ✓ ELP or ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

EPIG process

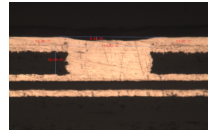
- ✓ ZEP Series
- ✓ IR Gold Series

Immersion process

- ✓ PROTIN Series

Electrolytic gold process

- ✓ HG 300 series
- ✓ SAU 10 series



동도금

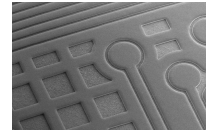
Copper plating chemical

Electroless Copper plating

- ✓ HVF Series
- ✓ MJH series

Electrolytic Copper plating

- ✓ BJ series
- ✓ HBJ Series(Half-fill)
- ✓ FSBJ Series(flash plating)
- ✓ ZEUS Series(Via-fill)



프로세스 약품

Process Chemical

DES Chemical

- ✓ MSAP/SAP DFR Stripper
- ✓ MSAP/SAP Cu seed Etchant
- ✓ GMZ Series
- ✓ HWA Series

Cleaner

- ✓ FXC Series
- ✓ EQ Series

Gold Recover

UBM Etchant

LAZ Process



5G 신기술

New product for 5G

No etching and roughness laminating pretreatment

Ultra low profile detachable thin copper foil

Positive Cu roughening

Process Nanotus®

Electroless Copper plating for LCP

Domestic Market situation

신규 사업분야
기존 사업분야

		"기존 사업영역"		"20년 신규진입분야"					
		FPCB, RFPCB		PKG		HDI		RIGID	
Major player	Domestic	<ul style="list-style-type: none"> SEMCO BH Flex Youngpoong Daeduck 	<ul style="list-style-type: none"> SEMCO Daeduck SIMTECH Korea Circuit 	<ul style="list-style-type: none"> Daeduck LG Innoteck Korea Circuit 	<ul style="list-style-type: none"> Hyunwoo SEIL 				
	Global	<ul style="list-style-type: none"> Zhending Technology Career Unimicron Mektron 	<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 	<ul style="list-style-type: none"> AT&S Zhending Technology Ibiden 	<ul style="list-style-type: none"> Various 				
Process Chemical		<ul style="list-style-type: none"> 점유율 확대중 Fine pattern 용 고부가가치 박리액 등 프로모션 	<ul style="list-style-type: none"> 19년 하반기 Major 고객사 첫 납품 시작으로 진입 	<ul style="list-style-type: none"> 박리 / 에칭 관련 매출 확대중 	<ul style="list-style-type: none"> - 				
Cu Plating	무전해	<ul style="list-style-type: none"> 국내 높은수준의 점유율 보유 (40% 이상 추정) 	<ul style="list-style-type: none"> 20년 1분기 첫 매출 발생 예정 	<ul style="list-style-type: none"> S사 높은 수준의 점유율 확보 	<ul style="list-style-type: none"> - 				
	전기용	<ul style="list-style-type: none"> New Business area - 외산 점유율 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 19년 하반기 외주를 통한 매출 발생 및 20년 확대 전망 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> - 				
Finish Plating	Electroless	<ul style="list-style-type: none"> 전세계 1위 점유율 확보 (50%이상) 	<ul style="list-style-type: none"> 고객사 평가중 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> 일부 국내 고객사 거래중 				
	Electro	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 	<ul style="list-style-type: none"> Developing 				

2020 시장전망

Market Review

- 카메라모듈용 PCB 생산물량 지속 증대
- 북미 A社 및 중국 스마트폰 제조사의 OLED 채택 모델 증가 전망, 단 코로나 이슈로 인한 연기와 물량감소의 Risk 또한 존재
- 국내 PKG Substrate 호황기 전망되나 나머지 PCB 시장에서의 Risk 존재

	최종표면처리(금도금)	동도금 화학소재	Process Chemical	기판가공 & 신사업
Domestic	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>OLED 탑재 모델 증가에 따른 한국 FPCB 제조사 물량 증가</u> ✓ 국내 카메라 모듈 증대에 따른 약품 소모 증가 ✓ FPCB를 넘어서 PKG Substrate의 금도금 시장 진입 시도 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ OLED RFPCB 적용 동도금 (MJH시리즈) 물량 확대 ✓ <u>FPCB, RFPCB용 비아필 전기동도금 시장 진입</u> ✓ <u>PKG Substrate 기판용 무전해화학동도금 런칭</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FPCB, RFPCB 미세회로 패턴용 회로공정 약품 프로모션 강화 ✓ <u>Substrate용 박리액 확대중</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 카메라모듈용 기판외주가공 물량의 지속 유지 (YPT) ✓ 비아필 전기동도금 외주가공 물량의 확대 (YPT) ✓ <u>Galaxy Z flip 모델 적용 및 20년 하반기5G 모델 프로모션</u>
Global	<ul style="list-style-type: none"> ✓ <u>중국 LOCAL 고객사의 카메라 모듈 확판에 따른 ENEPIG 물량 확대</u> ✓ 베트남 현지 고객사 가동률 및 한국 업체의 이전 확대에 따른 매출 성장 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 베트남 시장 무전해 화학동도금 매출 확대 (삼성전기, 비에이치 등) ✓ 20년 말 동도금약품 중국시장 런칭 및 현지 제조 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 베트남 및 중국 현지 업체 대상 회로공정 약품 프로모션 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ 중국 Local 업체 대상 5G EMI용 프로모션 강화, 중국 현지업체와 NDA 계약 후 판매 진행 ✓ 베트남 현지 FPCB 금도금 외주가공 매출 확대

2020 CAPEX 진행사항

극동박
제조설비 증설

- EMI Shield 기초소재, 국내 S社 向 납품 진행 및 중화권 업체 관심도 증가
- 1차 증설규모 : 7 만㎡ (월) / 현재는 RTR 외주와 라인을 공용으로 사용 중으로 Capa. 부족
- 대상지역 : 경기 안산, 1차 투자규모 : 약 30억 예상
- 현재 건설중으로 7월~8월 완공예정

중국법인
Chemical
제조공장 설립

- 중화권 고가 소재시장 점유율 대비 일반약품 시장 점유율 약세
- 중국 內 생산/판매를 통한 일반약품 시장에서의 가격경쟁력 강화 및 물량이 큰 화학동도금 약품 생산
- 대상지역 : 주하이 지역 약 4,000평 부지 확보, 연내 공장 착공 예정, 총 투자규모 : 약 70억원 예상
- 기초 공사중으로 20년말~21년 초 완공 예정

베트남법인
도금라인 증설

- 국내 고객사의 생산거점 이전으로 인한 베트남 현지 외주가공 물량 증대 예상
- 현재 금도금라인 2개 set-up 완료, 1개 라인 setting 중
- 현지 외주도금 수요량 예측을 통해, 추가 도금라인 증설 검토 중, 추가 투자규모 : 약 20억원
- 현재 검토중

반도체 PKG용
Chemical
제조설비 증설

- PKG용 소재 고객사 공급규모 증대 예상
- 현재 소규모 클린룸 및 제조설비 가동 중
- 고객사 공급물량 확대 시 클린룸 확장 및 설비 증설 검토, 추가 투자규모 : 약 30억 예상
- 검토중

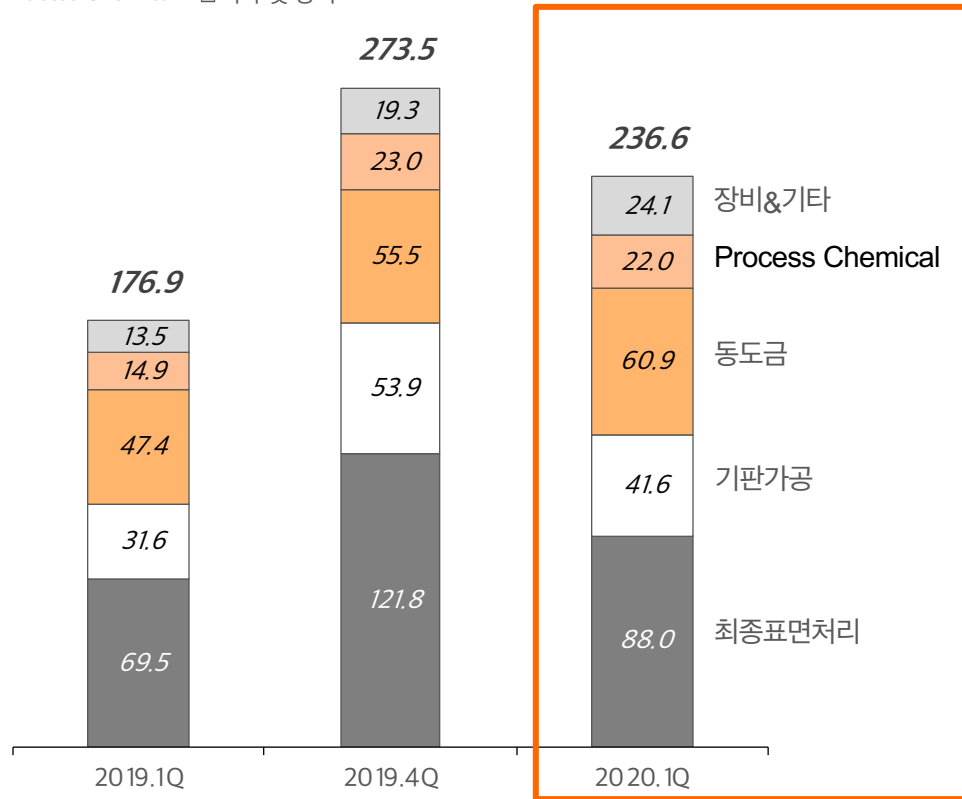
2020년 1분기 Review 및 2분기 예상

	2020년 1분기 Review	2020년 2분기 전망
최종표면처리(금도금)	<ul style="list-style-type: none"> 중국 Local 스마트폰 카메라 모듈의 증가로 중국 내수 매출 증가 한국 / 베트남 또한 신규 S시리즈 출시 물량으로 인한 수혜 	<ul style="list-style-type: none"> OLED 모델 출시연기 리스크 존재 특히 4월~6월은 스마트폰 신모델 출시가 적은 전통적 비수기 현재 북미 고객사 보급형 모델에 당사 금도금 프로세스 적용중.
동도금 화학소재	<ul style="list-style-type: none"> 한국 및 베트남 시장 FPCB 고객사 점유율 지속 확대 Substrate 1개 라인 현재 Test 중으로 현재까지 평가결과 양호 북미 고객사 악세사리 모델 적용중 	<ul style="list-style-type: none"> 신규 모델 부재로 인한 물량감소 전망 단, 스마트폰 외 무선 이어폰 등의 꾸준한 생산으로 일부 매출은 Cover Substrate 테스트 결과 확인 및 Promotion
Process Chemical	<ul style="list-style-type: none"> Substrate 향 박리액 확대중 FPCB / RFPCB 용 약품 점유율 확대중 	<ul style="list-style-type: none"> Substrate 향 박리액 확대중 FPCB / RFPCB 용 약품 점유율 확대중
기판가공	<ul style="list-style-type: none"> 카메라모듈 관련 외주도금은 지속적인 수요 발생 Via Fill process 외주도금 가동중 COVID 19로 인한 베트남 공장 외주가동 지연중 	<ul style="list-style-type: none"> 신 모델 부재로 인한 카메라모듈 물량 감소 전망
극동박 & 장비관련	<ul style="list-style-type: none"> 당사 극동박이 탑재된 EMI Film 최신 폴더블 스마트폰에 탑재, 현재 양산중 고객사 베트남 이전으로 인한 장비관련 매출 확대 	<ul style="list-style-type: none"> EMI 용 극동박 고객사 프로모션중

Sales Result

최종표면처리
 기판가공
 동도금
 Process Chemical
 기타 및 장비

(단위:억원)



- **20년 1분기 236.6억원 역대 최대 매출 달성**
 - ✓ 19년 동기대비 59.7억원 33.7% 매출 상승
- **Chemical 제품군의 지속적인 성장**
 - ✓ 최종표면처리 : 중국 시장 카메라모듈용 도금약품의 매출확대로
 - ✓ 동도금 : 한국, 베트남 시장 FPCB 고객사 지속적인 점유율 확대
 - ✓ 기판가공 : Via Fill 외주도금 양산 가동중
 - ✓ Process Chemical : Substrate PKG 고객사 진입으로 인한 전년 동기 대비 매출 상승
- **전 분기 대비 매출액 36.9억원, 13.5% 감소**
 - ✓ A사 OLED 모델 생산량 감소
 - ✓ S사 Flagship 모델의 판매 감소
 - ✓ 신제품 출시 주기로 상반기 보다는 하반기에 매출과 이익이 집중

Income Statement

(단위:억원)

	제 22기 1분기	매출비중	제 21기 1분기	매출비중
I. 매출액	236.6	100%	176.9	100%
II. 매출원가	157.4	66.5%	112.8	63.8%
III. 매출총이익	79.2	33.5%	64.1	36.2%
판매비와 관리비	38.6	16.3%	30.5	17.3%
IV. 영업이익	40.6	17.2%	33.6	19.0%
금융수익	16.7	7.1%	4.7	2.7%
금융비용	6.0	2.6%	2.6	1.5%
기타수익	0.3	0.1%	2.5	1.4%
기타비용	1.0	0.4%	0.3	0.2%
지분법손익	-0.5	-0.2%	0.1	0.1%
V. 법인세차감전순이익	50.1	21.2%	38.0	21.5%
법인세비용	11.5	4.9%	4.8	2.7%
VI. 당기순이익	38.6	16.3%	33.2	18.7%

주요 수익성 지표

	22기 1분기	21기 1분기
영업이익률	17.2%	19.0%
순이익률	16.3%	18.7%
EBITDA (마진율)	54.6 (23.1%)	43.2 (24.4%)
ROE	3.7%	3.8%
총자산회전률	14.3%	13.6%

Balance Sheet

(단위:억원)

	제 22기 1분기	제 21기
자산		
현금성자산	435.1	417.5
매출채권	263.6	264.7
유형자산	620.3	608.6
기타자산	347.6	348.5
자산총계	1,666.6	1,639.3
부채		
매입채무	38.5	33.0
차입금	324.5	344.7
전환사채	143.3	140.4
기타부채	206.3	216.9
부채총계	712.6	735.0
자본		
자본금	37.0	37.0
자본잉여금	218.6	218.6
이익잉여금	560.9	531.3
기타자본	137.5	117.4
자본총계	954.0	904.3
부채와 자본계	1,666.6	1,639.3

Cash Flow

(단위:억원)

	제 22기 1분기	제 21기 1분기
기초현금	417.5	276.1
영업활동으로 인한 현금흐름	50.0	25.0
순이익	38.6	33.2
감가상각비	13.9	9.6
이자비용	5.2	2.4
법인세비용	11.5	4.8
외화환산이익	(12.7)	(3.8)
자산부채의 변동	7.2	(19.6)
투자활동으로 인한 현금흐름	(19.1)	(25.0)
유형자산의 증가	(17.1)	(26.1)
재무활동으로 인한 현금흐름	(21.8)	18.9
차입금 증감	(20.1)	18.9
현금증감	9.1	18.9
환율변동효과	8.5	5.7
기말현금	435.1	300.7

END OF DOCUMENT

감사합니다.